

# SiC ウェーハ研削盤

## Model R631BM

**SEMICON<sup>®</sup>  
JAPAN**



ジェイテクトマシンシステム

## 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社はこのたび「SEMICON JAPAN 2023」へ出展いたしますのでご案内申し上げます。

今回は、SiCウェーハ研削盤R631BMの実機展示を行います。

この機会に是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

2023年11月吉日  
株式会社ジェイテクトマシンシステム  
代表取締役社長 宮藤 賢士

### 開催概要・出展位置

会期:2023年12月13日(水)~15日(金)

開催時間:10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト

出展位置:**東2ホール 2319**

共同出展:株式会社ジェイテクト、株式会社ジェイテクトグライディングツール

**JTEKT** 株式会社ジェイテクトマシンシステム